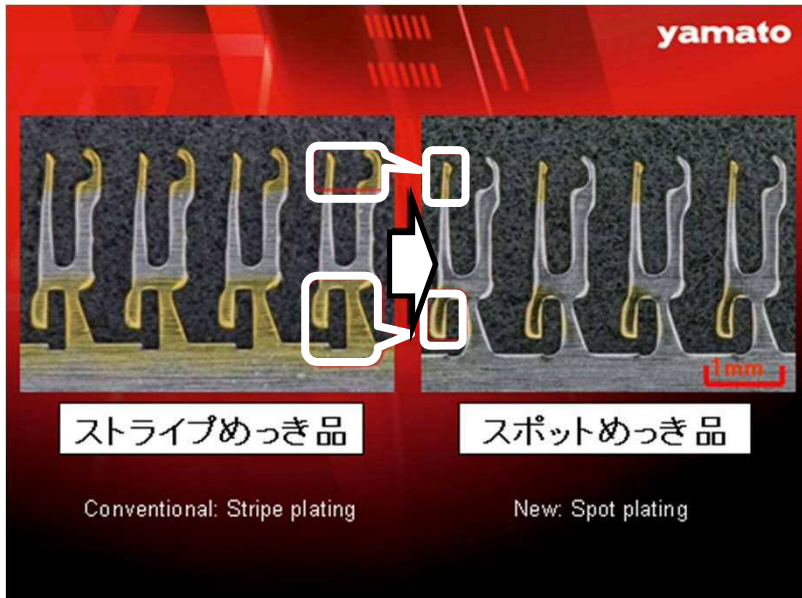


ひとわざ(一技)名: 超微細部分めっき加工

1. 概要(200字目安)

スマートフォンを始め近年のIT製品は軽薄短小化の流れの中、搭載されます電子部品は小型、薄型化を要求されます。  
 これらの部品には微細プレス製品が多数採用され、それに伴いめっき加工技術においても『必要なところへ必要なだけつける』技術が要求されます。  
 当社では自社設計製作にてオリジナルのめっき機器、マスク、治工具を駆使し超微細めっき加工を行います。

写真・図(要点説明)



当社では連続プレス製品、リードフレームへの部分めっきを承ります

例)連続プレスへの部分めっき技術は、従来は左写真のように、ストライプ上にめっきを施すことが標準的な加工方法でしたが、当社では 必要なところだけめっきを施す、連続スポットめっきが可能です

2. 企業概況

会社名	大和電機工業株式会社			代表者名	原 房利		
				窓口担当	原 雅廣		
事業内容	電子基板・部品・材料への機能めっき加工			U R L	<a href="http://www.yamato-elec.co.jp">http://www.yamato-elec.co.jp</a>		
主要製品	電子基板・部品・材料への機能めっき加工						
住所	〒393-0043 長野県下諏訪町5451						
電話/FAX	0266-27-3246 / 0266-27-3243			E-mail	<a href="mailto:mash@yamato-elec.co.jp">mash@yamato-elec.co.jp</a>		
資本金(百万円)	90	設立年月日	1944年4月	売上(百万円)	8,000	従業員数	400

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

①ISO9001、ISO14001②電子部品、エレクトロニクス関連